

財務概況

このセクション(財務概況)における業績は、2008年3月期の数値を示しており、比較は、2007年3月期と行っています。

当社は次の会計方針および事業区分の変更を行っています。

- 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から、原則として設置完了基準に変更いたしました。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法に比べ、売上高は80,956百万円、営業利益は20,541百万円、税金等調整前当期純利益は20,563百万円減少しております。
- 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置に係る保証期間中のアフターサービス費用については、従来の支出時の費用処理から、過去の支出実績を基準にして算出した見積額を製品保証引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法に比べ、営業利益は635百万円、税金等調整前当期純利益は13,106百万円減少しております。
- 当社は、2006年10月1日付けにて、コンピュータ・ネットワーク部門を東京エレクトロニクス株式会社に株式分割により移管しました。これに伴い、「産業用電子機器」セグメントに属していた「コンピュータ・ネットワーク」事業を、2007年3月期より「電子部品・情報通信機器」(旧「電子部品事業」)セグメントに区分変更しました。

損益状況

事業環境

当期の世界経済は、前半は中国の高成長、アジア諸国の堅調な成長により順調に推移しました。しかし、年度半ば以降、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界の金融市場の混乱、米国経済の成長の減速などが明らかとなり、世界経済の先行きに不透明感が強まりました。国内においては、前半は輸出の増加、企業収益の改善、堅調な設備投資を背景に緩やかな景気拡大が続きましたが、後半にかけて原油・原材料価格の高騰に加え、急激な円高・ドル安となり、景気に減速感が出てきました。

当グループの参画するエレクトロニクス産業においては、BRICsを中心とする新興経済圏の需要拡大効果もあり、PC、携帯電話などのモバイル・通信機器、デジタル家電の出荷が引き続き拡大しましたが、期の後半には成長率の鈍化が見られました。当社の業績に直接影響のある設備投資の状況としては、半導体設備投資は前半活況を呈したものの後半減速に向かい、液晶パネル設備投資は期を通して低調となりました。

	(百万円)				
	2004	2005	2006	2007	2008
売上高	¥529,654	¥635,710	¥673,686	¥851,975	¥906,092
売上総利益	140,155	175,913	189,732	272,649	311,298
売上総利益率	26.5%	27.7%	28.2%	32.0%	34.4%
販売費及び一般管理費	117,875	111,930	114,029	128,670	142,800
営業利益	22,280	63,983	75,703	143,979	168,498
営業利益率	4.2%	10.1%	11.2%	16.9%	18.6%
税金等調整前当期純利益	14,936	55,775	75,328	144,414	169,220
当期純利益	8,297	61,601	48,006	91,263	106,271

2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくは当セクションの冒頭にある記載をご参照ください。

売上状況

2008年3月期の連結売上高は、前期比6.4%増加の9,061億円となり、2007年3月期に続き2期連続で過去最高を更新しました。国内売上高は前期比3.2%増加の3,239億円、海外売上高は、特に半導体製造装置の台湾地域での売上拡大が寄与し、8.2%増加の5,821億円となりました。連結売上高に占める海外売上高の比率は前期の63.2%から64.2%に上昇しました。

また、当期の連結受注高は前期比23.8%減少の7,448億円、当期末の連結受注残高は前期末比33.2%減少の3,250億円となり、2009年3月期前半の売上減少が鮮明となりました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比2.7%増加の5,948億円、売上総利益は14.2%増加の3,113億円となりました。売上総利益率は2.4ポイント上昇して34.4%となりました。改善の主な要因は、半導体製造装置分野での新製品投入による売価向上、無償保証費用などの追加費用の低減、生産の効率化による原価低減などです。

販売費及び一般管理費は、前期比11.0%増加の1,428億円となり、売上高に対する比率は前期の15.1%から15.8%となりました。一般管理費に含まれる研究開発費が前期より91億円増加したことが増加の主な要因です。

これらの結果、営業利益は前期比17.0%増加の1,685億円、営業利益率は1.7ポイント上昇の18.6%となり、営業利益額、営業利益率とも2期連続で過去最高を更新しました。

研究開発費

当期の研究開発には、上述のように、前期比91億円、16.0%増加の661億円を投じました。

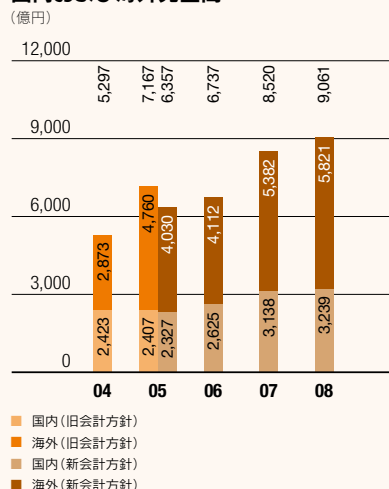
分野別に見ると、半導体製造装置では、半導体デバイスの微細化への対応のみならず、さらなる高速化、低消費電力化を実現するための新材料への対応が求められており、これらに応える新技術・新製品の開発に取り組みました。当期は、こうした継続的な研究開発、製品開発の成果として、オーバーヘッド時間を短縮するなどさらに基本性能を向上させた熱処理成膜装置「TELINDY PLUS™」、High-kメタル膜を形成する枚葉CVD装置「Trias® high-k CVD」、業界トップレベルのウェーハ処理枚数を実現した枚葉洗浄装置「CELLESTA®+」のニューモデル3製品を市場リリースしました。FPD製造装置では、主に大型基板に対応する装置開発を引き続き行いました。

こうした既存分野における新技術・新製品の開発のみならず、優れた特性を持つRLSA*1プラズマソースを使用する装置の開発、有機EL製造装置開発、MEMS*2関連製品開発など、新規事業創出のための開発投資も行いました。

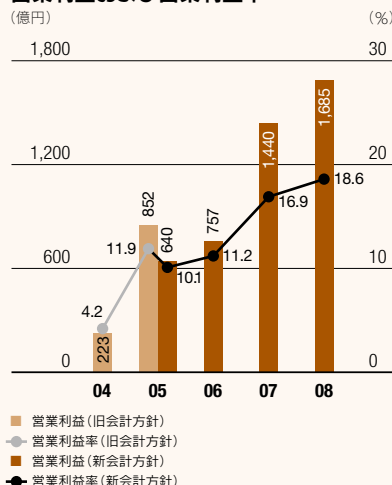
*1 RLSEA: Radial Line Slot Antenna (低電子温度を特徴とする新プラズマ源)

*2 MEMS: Micro Electro Mechanical System (半導体プロセスで作る微小電子機械システム)

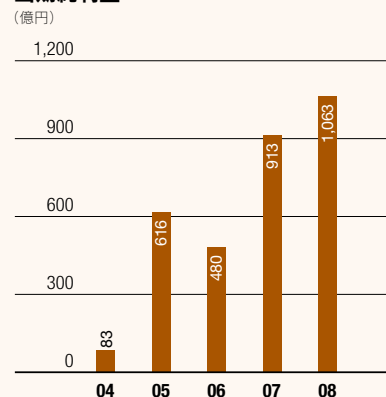
国内および海外売上高



営業利益および営業利益率



当期純利益



その他収益(費用)および当期純利益

当期は、2001年2月に取得した100%子会社Timbre Technologies, Inc.の再評価に伴うのれんの追加償却として41億円を計上しましたが、開発補助金収入22億円、固定資産売却益24億円などがあつたため、その他収益(費用)はネットで7億円となりました。この結果、税金等調整前当期純利益は、前期比17.2%増加の1,692億円となりました。

当期純利益は前期比16.4%増の1,063億円となり、2期連続で過去最高を更新しました。1株当たり当期純利益は、前期の511.27円から594.01円となりました。

配当政策および当期配当金

当社は、業績連動型・収益対応型の配当を行うことを株主還元の基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途とする配当を実施しています。

当期の1株当たりの配当金は、当期の業績と株主重視の方針を勘案し、前期比22円増加の125円とさせていただきました。この結果、配当性向は連結ベースで21.0%となりました。

尚、内部留保金につきましては、さらなる成長のための研究開発投資、設備投資などに有効に活用していきます。

セグメント別の状況

産業用電子機器事業

当セグメントの2008年3月期における売上高(他のセグメントへの内部売上を含む)は、前期比6.6%増加の7,960億円となりました。営業利益は17.4%増加の1,648億円、営業利益率は1.9ポイント上昇し、20.7%となりました。

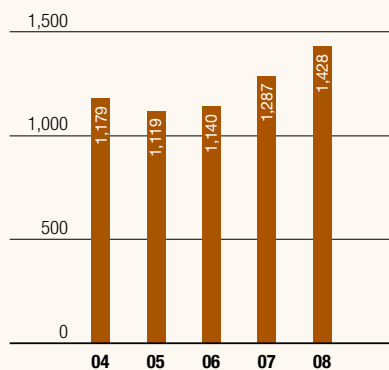
■半導体製造装置

当事業の外部顧客への売上高は、13.0%増加の7,264億円でした。

PCや携帯電話の世界的需要拡大やデジタル家電の普及などを背景に、これらの電子機器に搭載されるDRAM、NANDフラッシュメモリが堅調に需要を伸ばし、期の前半は今後のさらなる需要拡大期待から設備投資が活発に行われました。しかし、後半から、半導体需給バランスの悪化に伴うDRAM価格の下落などにより、半導体メーカーの投資意欲が次第に後退し、装置市場は調整局面に向かいました。

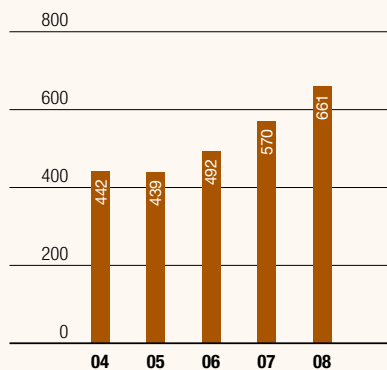
販売費及び一般管理費

(億円)



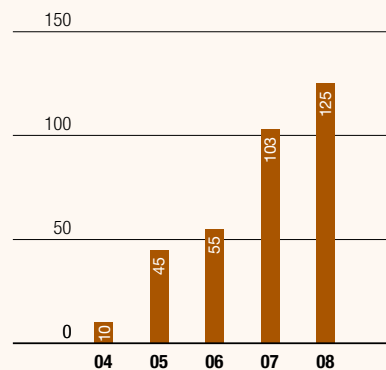
研究開発費

(億円)



1株当たり配当金

(円)



売上を地域別に見ると、台湾向けの売上が前期比79.8%増加と著しく伸び、日本向けも9.2%増加と高い伸びを示しました。米国向けは2.9%増加、欧州向け23.0%減少、韓国向け31.0%減少、中国向け0.7%増加、東南アジア向け13.7%減少でした。

製品群では、ウェーハプロバを除く全装置群で売上が前年を上回り、中でも枚葉CVD製造装置の売上が大きく伸びました。

尚、当事業の通期受注高は半導体メモリ価格の急落により期の前半より減速し、前期比37.0%減少の5,041億円、期末の受注残高は54.6%減少の1,846億円となりました。

■ FPD製造装置

当事業の外部顧客への売上高は、前期比32.5%減少の680億円でした。

液晶パネルが搭載される薄型テレビが、デジタル放送への移行と低価格を背景に急速に普及してきており、パネル需要を押し上げています。こうした中、日本・韓国・台湾の液晶パネルメーカーが2006年に行った能力増強投資の影響で2007年のパネル需給バランスが悪化し、当期の設備投資が抑制されました。

当社は、第7、第8世代の大型基板向け装置を中心に拡販活動を行いましたが、日本向けが17.1%の減少、韓国向けが7.7%の増加、台湾向けが63.1%の減少、その他の地域は29.4%の減少となりました。

尚、期の後半から再び液晶パネル需給が改善に向かい、パネルメーカーからの発注が再開しました。当事業の通期受注高は前期比94.2%増加の1,299億円、期末の受注残高は94.9%増加の1,271億円の過去最高となりました。

■ その他

その他の売上は、主に、損害保険代理業務、旅行代理業務などの内部サービス関連業務の売上です。売上高は、前期比59.4%減少の5億円となりました。

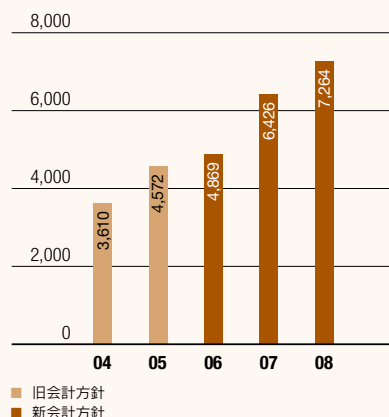
電子部品・情報通信機器事業(東京エレクトロンデバイス株式会社)

当セグメントの2008年3月期における売上高(他のセグメントへの内部売上を含む)は前期比3.1%増加の1,121億円でした。営業利益は7.8%減少の37億円、営業利益率は0.4ポイント低下し、3.3%となりました。また、当セグメントの外部顧客への売上高は、前期比3.5%増加の1,112億円となりました。

期の後半から日本経済の景況感悪化に伴い、国内の半導体市場もやや減速に向かいましたが、企業における情報セキュリティや内部統制関連の法整備を背景にIT投資は堅調でした。

半導体製造装置売上高

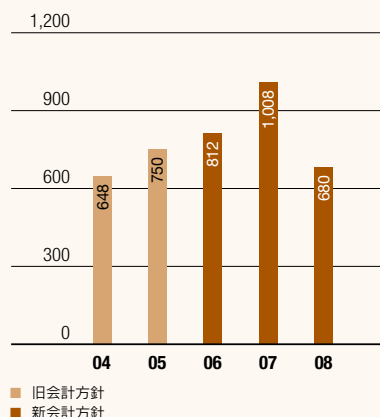
(億円)



注記：1. 2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門の売上高から分離して開示しています。本グラフ上の2004年3月期の半導体製造装置売上高は、読者の利便性を考慮し、単独ベースでのFPD製造装置売上を差し引いた数字で示しています。(数字：監査対象外)
2. 2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくはP28をご参照ください。

FPD製造装置売上高

(億円)



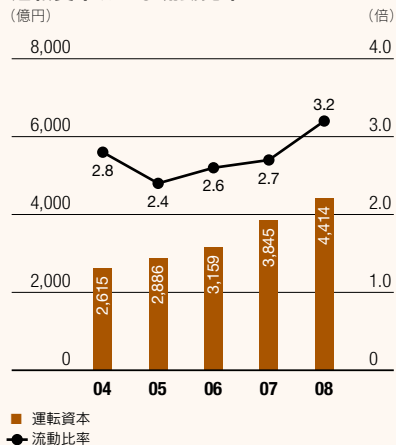
注記：1. 2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門の売上高から分離して開示しています。本グラフ上の2004年3月期のFPD製造装置売上は単独ベース、2005年3月期より連結ベースで示しています。
2. 2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくはP28をご参照ください。

当事業の重点戦略マーケットは産業機器分野です。カスタムICやアナログICなどの高付加価値デバイスの販売に注力するとともに、半導体設計受託業務の拡大と自社商品（ブランド名「インレピアム」）の開発強化に注力しました。また、コンピュータ・ネットワーク機器およびIT関連ソフトウェアにおいては、顧客の企業戦略に最適なソリューションを提供すべく、販売力ならびに保守サービス力の強化に努めました。

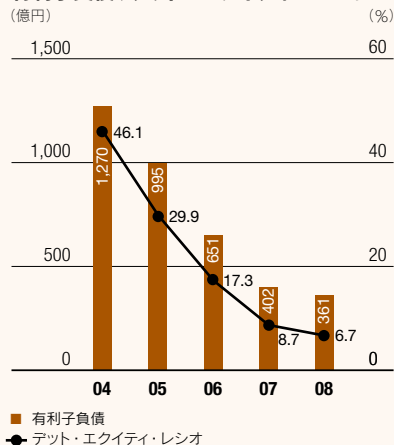
セグメント情報

	百万円				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
2008:					
1. 売上高及び営業利益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	¥794,911	¥111,181	¥906,092	¥ -	¥906,092
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,117	948	2,065	(2,065)	-
合計	796,028	112,129	908,157	(2,065)	906,092
営業費用	631,220	108,470	739,690	(2,096)	737,594
営業利益	164,808	3,659	168,467	31	168,498
2. 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出					
資産	¥744,280	¥ 51,459	¥795,739	¥(2,921)	¥792,818
減価償却費	22,649	365	23,014	-	23,014
のれん追加償却額	4,072	-	4,072	-	4,072
減損損失	808	-	808	-	808
資本的支出（無形固定資産及びその他資産への支出を含む）	26,924	924	27,848	-	27,848

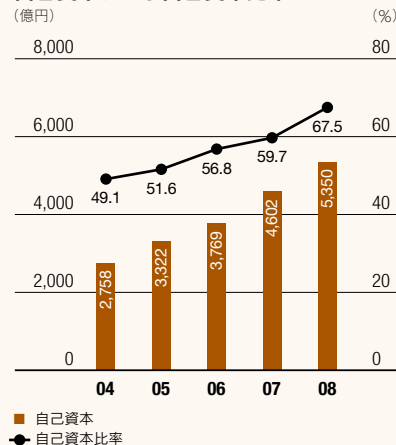
運転資本および流動比率



有利子負債、デット・エクイティ・レシオ



自己資本および自己資本比率



財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

■ 資産

2008年3月期末の総資産は、前期末から223億円増加の7,928億円となりました。

流動資産は、前期末比299億円増加の6,402億円となりました。売上債権の回収が進み、譲渡性預金を含む現金及び預金が692億円増加する一方、期末に向けて工場仕掛品と出荷済み未設置在庫が減少に向かい、たな卸資産が337億円減少したことによるものです。

有形固定資産は、新規取得分が227億円ありましたが、生産子会社である東京エレクトロン九州(株)熊本事業所封鎖に伴う減損損失8億円、減価償却実施額214億円などを差し引き、ネットで8億円減少の1,041億円となりました。

投資その他の資産は、2001年2月に取得した当社100%子会社Timbre Technologies, Inc.のビジネスを再評価し、のれんの追加償却41億円を計上したことなどにより、前期末比で67億円減少し、485億円となりました。

■ 負債及び純資産

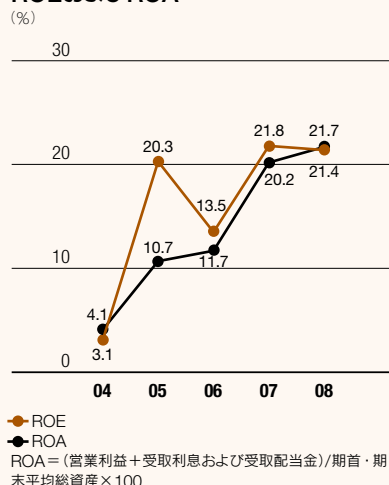
総負債は前期末比531億円減少し、2,476億円となりました。

流動負債は、前期末比270億円減少の1,988億円となりました。減少の大きな要因として、支払手形及び買掛金301億円の減少、未払法人税等174億円の減少がありました。一方、一年以内返済予定長期借入金及び社債は前期比215億円増加の300億円となりました。これは、第5回ワラント債55億円の償還と東京エレクトロンデバイスの借入金の返済30億円があったものの、第11回無担保社債の償還期限が1年以内になったことによる流動負債への振替が300億円あったことによるものです。

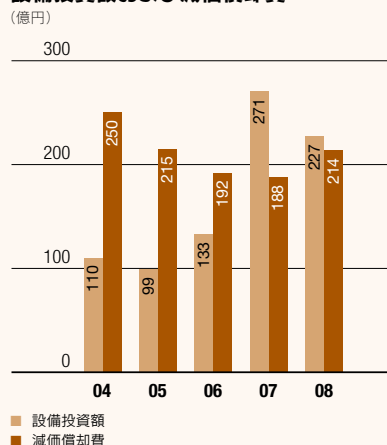
純資産は、利益剰余金が前期末比828億円増加したことを主な要因に、754億円増加の5,452億円となりました。これにより自己資本比率は前期比7.8ポイント増加の67.5%、自己資本当期純利益率(ROE)は0.4ポイント低下し21.4%となりました。

尚、当期末の長短合わせた有利子負債残高合計は、第11回無担保社債の償還が1年以内になったことで長期負債がゼロとなり、短期借入金と一年以内返済予定長期借入金及び社債を合わせた361億円のみとなりました。これにより、デット・エクイティ・レシオ(有利子負債/自己資本比率)は前期末の8.7%から6.7%にさらに低下しました。

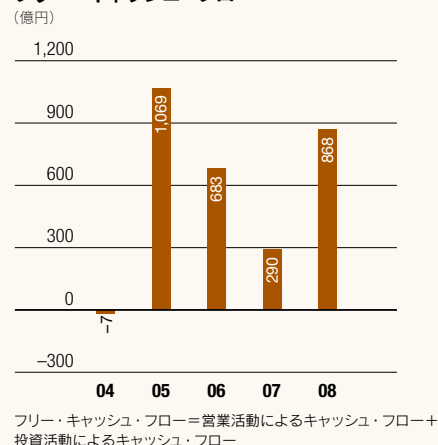
ROEおよびROA



設備投資額および減価償却費



フリー・キャッシュ・フロー



設備投資額*1および減価償却費*2

当期の設備投資額は、前期比16.3%減少の227億円となりました。設備投資の内容は、半導体製造装置およびFPD製造装置の研究開発用の評価機・測定器の取得、建物設備の取得が主なものでした。減価償却費は13.8%増加の214億円でした。

*1 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。

*2 減価償却費にはのれんの減価償却額および追加償却額は含まれていません。

キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比626円増加の1,169億円でした。主な内容としては、税金等調整前当期純利益1,692億円、減価償却費214億円、受取手形及び売掛金の減少25億円、たな卸資産の減少283億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラス要因となった一方、仕入債務の減少274億円、及び法人税等の支払額737億円がキャッシュ・フローのマイナス要因となったことによるものです。

投資活動に使用したキャッシュ・フローは、前期比49億円増加の302億円となりました。主な内容としては、将来の成長に向けた研究開発用の評価用装置・測定器などの有形固定資産の取得に193億円、および、満期が3ヶ月を超える預金への預け入れ101億円です。

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、前期比77億円減少の270億円となりました。主な内容は、第5回無担保新株引受権付社債55億円の償還、配当金の支払い234億円です。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、591億円増加の1,935億円となりました。

事業などのリスク

当社の経営成績、財務状況および当社株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっています。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としていますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約などによって為替リスクヘッジに努めています。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術などの最先端技術について積極的な研究開発投資および研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれなどの影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置などのハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加などの発生により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品および顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5)安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理などの各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しています。しかしながら、当社製品に関連する安全性などの問題により、顧客への損害発生、受注取消などが発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6)品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、およびレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用して頂くことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品であるなどの原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生するなどにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7)知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略および知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や知的財産権を回避する場合などがあるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8)その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業におけるさらなる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社および他業種企業と同様に、世界および各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症などの不可抗力、金融・株式市場、政府などによる規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失などの影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。